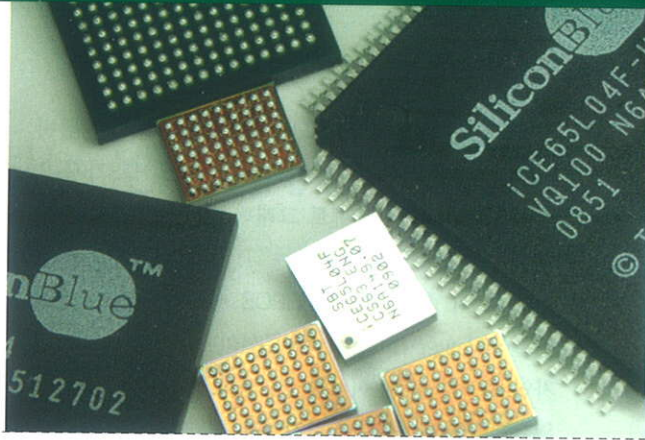


실리콘블루(SiliconBlue®) 테크놀로지는 핸드헬드 시장을 겨냥한 자사의 초저전력 65나노 공정을 이용한 SRAM 기반의 FPGA 제품이 양산체제로 돌입하였다고 발표했다. 이 제품군은 iCE65L02, iCE65L04와 iCE65L08 3가지의 제품들로 이루어져 있으며 몇 달 안으로 완전한 제품 라인업이 구성 될 것이다.



SiliconBlue, 초저전력 65나노 공정을 이용한 FPGA 제품 양산체제 돌입

글 | 이공홀 기자(leekh@semiconnet.co.kr)



Kapil Shankar

실리콘 블루의 CEO인 Kapil Shankar 씨는 “이 iCE 제품군은 업계 최초의 비휘발성 FPGA로서 빠르게 성장하는 배터리 전원 컨슈머 핸드헬드 제품을 겨냥하여 초저전력, 초저가 및 가장

작은 패키지를 제공함으로써 핸드헬드 제품에서 중요하게 요구되는 사용자의 디자인 사양 및 양산 단가를 개선시킬 수 있는 솔루션을 제공합니다”라고 말하고 “전 세계적으로 가장 크고 전문화된 파운드리 회사인 TSMC 생산라인을 이용하기 때문에 사용자의 대량 양산 요구에 빠르게 대처가 가능하며 사용자들도 다른 솔루션보다 빠르게 양산 체제로 전환할 수 있습니다”고 덧붙였다.

Kapil Shankar은 “실리콘 블루가 저전력 65나노 CMOS 공정을 사용하여 유례를 찾아 볼 수 없는 ASIC 구조와 같은 저전력, 싱글 칩 솔루션을 출시하게 됨으로써 급속하게 성장하는 컨슈머 핸드헬드 시장의 요구에 이상적으로 부응할 수 있는 FPGA 솔루션을 가지게 된 것에 대해 흥분을 감출 수가 없다”고 설명했다.

컨슈머 모바일 디바이스는 기존의 경험해 보지 못한 엄청난 변화를 하고 있다. 제품으로는 PDA, MID,

DPF, POS, 카메라, MP3, GPS, 게임기, 이메일과 인터넷 브라우저 등이다. 이러한 제품들은 기본적으로 같이 설계할 수 없는 기능들을 가지고 있기 때문에 iCE65 FPGA 를 사용하여 새롭게 사용되는 ASSP 와 상용 소자와의 연결을 자연스럽게 할 수 있다.

전례 없는 ASIC과 같은 로직 성능을 이용하여 실리콘 블루의 iCE65 FPGA는 재 컨피그레이션이 가능한 SRAM 을 바탕으로 내부에 실리콘 블루의 특허인 컨피그레이션 메모리인 NVCM를 내장하여 싱글 칩 솔루션을 가능하게 했다. 외부의 플래시 PROM을 없앴으로써 사용자에게 가격적인 면에서도 장점을 주는 동시에 디자인 편리성까지 도모하였다. 실리콘 블루는 또한 사용자의 하드웨어 언어인 VHDL, Verilog 를 제공하는 iCEman™ 소프트웨어 환경을 제공하고 있으며 평가 키트인 the iCEman™ 시험 보드도 제공하고 있으며 핸드헬드 응용에서 범용적으로 많이 이용되고 있는 기능의 IP 코어와 턴키 디자인을 제공하고 있다.

iCE65L02, iCE65L04 와 iCE65L08 제품은 현재 사용 가능하며 대량 주문시 1불 이하의 가격에도 가능하다. 3.2mm x 3.9mm 크기의 iCE65L04의 CS63 패키지는 업계에서 가장 작은 사이즈 패키지에 높은 로직 성능을 가지고 현재 대량 양산이 가능한 최초의 FPGA 패키지이다. 이 제품들은 VQFP, BGA, WLCSP와 KGD(Known Good Die) 와 같은 모든 패키지에서 대량 양산 주문이 가능하다.

www.siliconbluetech.com 